

【パッケージ / Package : SOT-89-5】

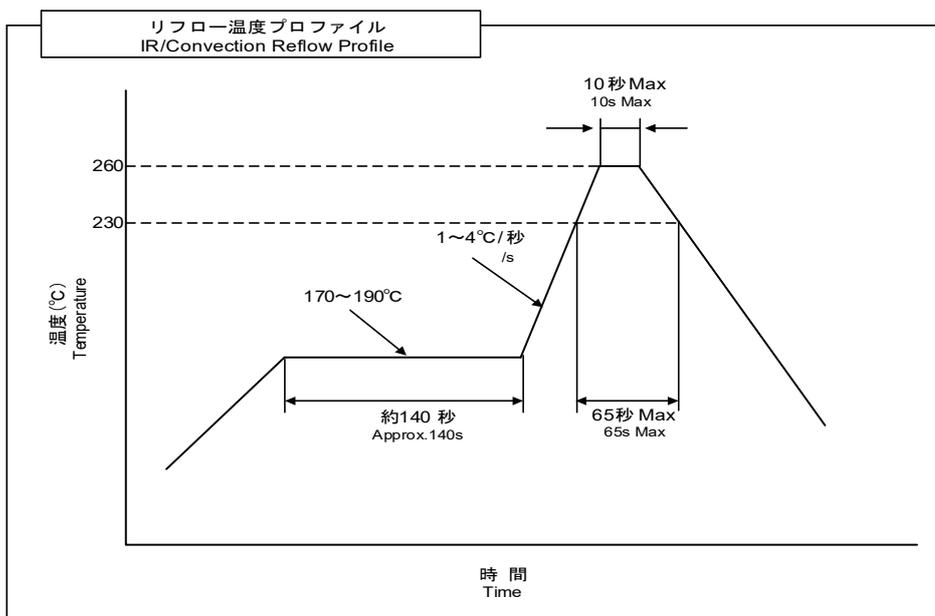
シリーズ名 Series Name	製品質量 (mg) Product Mass (mg)	MSL	リフロー Reflow ※	フロー Flow ※	手はんだ Manual ※
XA6210	57	1	可 available	可 available	可 available
XA6216					
XA6220					
XA6222					
XC6204					
XC6205					
XC6207					
XC6209					
XC6210					
XC6216					
XC6219					
XC6220					
XC6222					
XC6223					
XC6227					
XC6231					
XC62H					
XC6371					
XC6372					
XC6402					
XC6403					
XC6404					
XC6405					
XC6408					
XC6413					
XC6414					
XC6503					
XC6505					
XC6601					
XC6602					
XC6701					
XC6702					
XC6801					
XC6802					
XC6901					
XC9260					
XC9261					
XC9267					
XC9268					
XD6216					
XD6702					
XD9267					
XD9268					
XE6216					

【パッケージ / Package : SOT-89-5】

※ はんだ付け条件 (以下の条件の範囲内でご使用下さい)

Soldering Conditions (please use within the following conditions.)

1) リフローはんだ(3回) / Reflow Soldering Temperature Profile (three times)



2) フローはんだ(1回) / Flow soldering (once)

項目 Item	条件 Conditions		備考 Notes
予備加熱 Pre-heat	温度 Temperature	80~150°C	基板表面温度 Surface temperature of P.W.B.
	時間 Time	3分max. 3min max.	
はんだディップ Solder dipping	温度 Temperature	260°C	はんだ槽温度 Temperature of solder
	時間 Time	10秒max. 10s max.	はんだ槽通過時間 Path time

3) 手はんだ(2回) / Manual Soldering (twice)

こて先温度 400°C以下 時間 3秒以内 / Bit Temperature: Under 400°C Time: Under 3s